

高速・高精度なシリコン  
ウエーハエッジ研磨装置  
を製造

# 株式会社 BBS金明

石川県  
白山市旭丘1-11

1956年(昭和31年)設立  
Tel 076-275-6131

<http://www.bbs-ltc.com/index2.htm>



代表取締役  
川原 幸夫

携帯電話、パソコン、テレビ、自動車等、身の周りにある、あらゆる機器に使われている半導体デバイス。その基となっているシリコンウエーハのエッジ研磨装置で世界シェアの90%以上。

## 時代のニーズを捉えた高速・高精度なエッジ研磨装置

半導体デバイスは今日、あらゆる機器に使われており、その用途は拡大の一途を辿っている。同社はいち早くこのニーズを捉え、従来とは全く異なった方法でシリコンウエーハの端面を高速・高精度に研磨することが可能な装置を開発した。この装置は世界中のメーカーから高い評価を受け、その世界シェアは90%を超えている。

## 工作機械で培った技術をもって半導体関連分野に進出

工作機械・産業機械の製造の中で培った技術を生かしてシリコンウエーハ研磨装置の製造を開始した。シリコンウエーハは大口径化すれば、基板を取れる面積が増え生産効率があがる一方、塵等が発生しやすくなり歩留まりが落ちてしまう。そこで、それまで表面の加工が主であったウエーハ研磨において、端面までをすばやく、しかも高精度で研磨可能な技術を開発することにより大口径シリコンウエーハの量産を可能とした。

## 社名のBBS (BUILDING BLOCK SYSTEM) はモノ作りの考え方

社名にあるBBSは「ビルディング・ブロック・システム」を略したもので、同社における加工用装置製造の考え方である。一つの部品のための専用装置を作るのではなく、その部品も含めて想定されるあらゆる種類の部品加工ができる装置の体系を設計しておき、全ての部品加工をその装置の体系にあてはめて専用装置化するというモノ作りの考え方である。



シリコンウエーハ



ウエーハエッジ研磨装置  
(E-300UCS)